

# 窒化アルミニウム

## FUJI AIN シリーズ

窒化アルミニウムとは、アルミニウムと窒素の化合物で、熱伝導率が高く、電気を通さない絶縁性をもつ高機能な素材です。優れた熱伝導性、高い電気絶縁性、シリコンに近い熱膨張等の特性を持っており、放熱性が求められる用途(例:熱を持つことで動作が不安定になる半導体など電子部品の放熱材料用途)を含め、高熱伝導用材料として注目されています。耐薬品性も高いという特徴もあります。近年では省エネルギー効果が期待されるLEDの放熱基板としても注目を集めています。

用途: パワートランジスタモジュール基板、発光ダイオード用マウント基板、ICパッケージ、放熱基板、LED パッケージ用基板、半導体用基板、薄膜回路基板、パワー抵抗器用基板、放熱グリス、放熱パッド、金属基板のコーティング材、半導体などの封止材、焼結体用原料、サイアロン系化合物用原料、各種添加物

- ・高熱伝導率(アルミナフィラーの約7倍)熱伝導率 : 180-200 W/mK
- ・高い電氣的絶縁性 電気絶縁性 :  $>10^{14} \Omega/\text{cm}$

粉体の形態で供給可能です。分散体、スラリー、ペースト(粒子径制御、水、各種有機溶剤)などは検討中です。

技術的な詳細を含めいつでもご相談ください。